

⑨日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑪公開特許公報(A)

昭54-79892

⑫Int. Cl.<sup>3</sup>  
B 24 C 1/06

識別記号 ⑬日本分類  
74 K 11

庁内整理番号 ⑭公開 昭和54年(1979)6月26日  
6660-3C

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 2 頁)

⑮亜鉛メッキ銅板等のメッキ層除去方法

東芝タンガロイ株式会社内

⑯発明者 東方幸男

川崎市幸区塚越1丁目7番地

⑰特 願 昭52-146141

⑱出 願 昭52(1977)12月7日

東芝タンガロイ株式会社内

⑲発明者 軽部光一

⑳出 願 人 東芝タンガロイ株式会社

川崎市幸区塚越1丁目7番地

川崎市幸区塚越1丁目7番地

## 明 細 書

### 1 発明の名称

亜鉛メッキ銅板等のメッキ層除去方法

### 2 特許請求の範囲

全表面に亜鉛メッキ層等が被覆されている銅板において、溶接性向上のため、メッキ層の一部を除去するにあたり、60～80メッシュの炭化硅素粒、φ.0粒等を8%以上の圧力で吹付け加工処理することにより、該メッキ層の一部を除去したことを特徴とする亜鉛メッキ銅板等のメッキ層除去方法。

### 3 発明の詳細な説明

本発明は、亜鉛メッキ銅板等のメッキ層除去方法に關し、特に、除去部分にヤズ、歪などが残らず、またその作業が簡単に出来ない得るようにしたものである。

従来、この種の亜鉛メッキ銅板等は、メッキ層中に浸透される工程を経るため、全表面にメッキ層を有するのが普通である。

しかし、用途によつては、片面のみあるいは、

一部分メッキ層を有しない銅板も要求されることがある。これは、一般に溶接に伴うものであり、全表面にメッキ層を有する銅板では溶接部分のメッキ層除去作業として問題となつていゝものである。

そこで、本発明は、上述の点に鑑みをされたもので、全表面に亜鉛メッキ層等が被覆されている銅板において、メッキ層の一部を除去するにあたり、60～80メッシュの炭化硅素粒、φ.0粒等を8%以上の圧力を吹付け加工処理することを内容とするものである。

以下、本発明亜鉛メッキ銅板等のメッキ層除去方法における一実施例について説明する。

亜鉛メッキ銅板は、一般に耐食性がよく、亜鉛の定着性もよいため、種々の用途に適用されるが溶接加工を伴ふ分野では、メッキ層が片面あればよい場合がある。しかし、従来のようなサンドペーパーによるメッキ層の除去作業では、目詰りから問題があり、また、きざげ等によつてはヤズの問題がある。

これに対し、本発明では、炭化繊維、 $\text{SiC}$ 、ガラスビーズ等の粒子を吹付け加工することによりメッキ層の除去をするものである。したがってメッキ層の片面全面あるいは、その一部を確実にしかも簡単に除去できるものである。

この場合、一部除去のときは、除去しない部分をテープ等でマスキングすることにより得られる。また、粒子の大きさは、メッキ層の条件により異なるが、一般には $50 \sim 80 \mu\text{m}$ のものが適当とされ、その圧力は、 $5 \text{ MPa}$ 以上一般には、 $5 \sim 7 \text{ MPa}$ の範囲から選択される。

なお、片面全面を除去する場合には、鋼板のメッキライン中に組込むことも可能である。これは、片面のみのメッキ作業を考えた場合そのメッキ槽に関連する装置の施設化において経済的負担が大きく本発明による除去工程を盛り入れた方がより経済的であること、また鋼板にも磨耗や、歪等が発生しないことからである。

以上説明したように、本発明の圧射メッキ剥離等のメッキ層除去方法は、ノズルから吹付けるよ

特開 昭54-79892(2)

うにすれば簡単に実現できるものであり、特にメッキ鋼板のメッキライン中にも簡単に設置として組込むことができることから、工業的価値が大きいという利点を有する。

発明者 菅野 誠人 東芝ダンダロイ株式会社